



Tagesordnung

Thema:	72. Treffen des Arbeitskreises „Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und Verbindungstechnologien“
Datum:	3. Mai 2021, 10.00 Uhr
Ort:	Fraunhofer IZM, Berlin Online via MS Teams
Teilnehmer:	AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Wellenhöhenmessung
Herr Neiser, SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim
- 3 10:50 Uhr
Metall-Keramik-Substrate & Silbersintern von Metall-Keramik-Substraten
Herr Dr. Schwöbel, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau
- 4 11:30 Uhr
Gedruckte Elektronik: Technologien, Anwendungen und Herausforderungen
Frau Neermann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg
- 5 12:10 Uhr
Mittagspause
- 6 13:10 Uhr
Mechanische Werkstoffcharakterisierung an dünnen Filmen
Herr Dr. Walter, Fraunhofer IZM, Berlin

- 7 13:50 Uhr
Die 5 häufigsten Fehler in der Baugruppenfertigung und ihre sichere Erkennung
Herr Kokott, Göpel electronic GmbH, Jena
- 8 14:30 Uhr
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr
MLCC Zuverlässigkeit
Herr Dr. Leib, Fraunhofer IISB, Erlangen
- 10 15:40 Uhr
Leiterplattenoberflächen – Retrospektive mit Ausblick
Herr Schmidt, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr